FIB制样单（附表）

|  |
| --- |
| **说明：聚焦离子束系统（FIB）用Ga+离子源对样品进行切割。由于Ga离子能量较高，所以可能会对材料本征的一些东西造成损伤，引起Ga离子注入以及辐照损伤等。所以FIB制样后，即使样品本征变化，但制样厚度达到拍摄透射电镜的要求，则制样成功。** |
| **样品数量及编号** |  |
| **样品化学组成** |  |
| **磁性情况**即是否含有铁钴镍等磁性元素 |  |
| **样品性质** | 导电性：硬度：脆性、韧性：  |
| **样品形态** | （长\*宽<100\*100mm，高<20mm，重量<500g，样品表面平整，表面起伏不超过2mm） |
| **制样目的** |  |
| **制样要求** | 具体要求（请附图进行详细描述）测试面的照片图（指明制样位置）样品背面（非测试面）照片图附一张上次TEM的结果（非本样品） |